

2016年に設立された新興のCMOSイメージセンサー(CIS)開発企業が注目を集めた。(株)Imaging Device Technologies(IDTC)

と呼ばれるその企業は、新横浜にオフィスを構え、設立わずか2年で49人にまで人員を拡大、18年中に70人強に人員を拡充する予定だ。中国の300mm半導体製造会社HiDM(徳准半導体)とパートナーシップを構築し、垂直統合型を志向、いよいよ18年から量産出荷を開始する。

■「CISは水平分業型に馴染まない」

同社は16年4月に設立されたCIS開発企業。代表取締役社長を務める浅見哲也氏は元国内大手電機メーカー技術者で、ASIC、スーパーコンピュータ用チップおよびCISの開発に従事。ただその後、会社は15年にCIS事業からの撤退を発表。同氏をはじめ、現在IDTCに所属する多くの従業員が同社出身者で固められている。

IDTCは一見すると、CISのファブレス企業に見ら

## 国内大手電機出身者らが設立 HiDMと協業、18年から量産出荷

浅見哲也社長



の事業展開を模索する。自社ブランドの展開では、モバイルのようなスマートフォンだけでなく、インタストリアル、メディカル分野のようなニッチマーケットも重要な候補となる。加えて、大企業には対応が難しい生産数量が少ない特定顧客向けカスタム製品開発への展開も強く意識する。

れがだが、実は垂直統合型(IDM)を志向する半導体メーカーだ。垂直統合型を志向するのは浅見氏の「CISはアナログLSIであり、ファブレスファウンドリーのような水平分業型スタイルは馴染まない」という思いからだ。CISでは垂直統合型が欠かせない要素と見ており、デバイス開発、設計開発、評価開発といった機能に関しては自社で保有している。

肝心の製造に関しては、中国HiDM社と連携して機能を補完している。HiDMは現在、江蘇省淮安市に300mm工場を建設し、18年10〜12月期からエンジニアリングサンプル(ES)の出荷開始を予定している。

ここで重要になるのが、設立当初から掲げるオープンイノベーション戦略だ。自社の強みを活かしつつも、国内外問わず、企業や組織の垣根を越えて、それぞれの強みを活かした共同開発を進めることで、これまでにない付加価値の高い、独創的な製品を生み出すことができるという。

まずはHiDMブランドで製造・販売する予定であり、IDTCはデバイスの開発・設計部門を担当、「HiDMのR&D機能は当社が担っている」(浅見氏)。スマートフォン(スマホ)などモバイル機器向けのBSI(裏面照

射型センサー)を量産予定で、画素数は1600万クラスとなる見込み。主要ターゲットは中華圏スマホの中心機種「(同氏)と位置づける。製造を担当するHiDMは淮安市に300mm製造棟を2棟建設する予定であり、現在その第1棟目にあたるFab1が完成している。Fab1内の生産キャパシティは19年度中に月産2万枚へ引き上げる。必要な製造装置の発注はすでに行っているという。

中国の新興企業と深いパートナー関係にありながらも、浅見氏はIDTCで進める事業展開を「日本にとっては半導体開発の新しい手法になる」と期待を寄せる。資金力が豊富なアジア企業と連携を図ることで、日本の半導体産業の再興にもつながると信じて、さらなる事業拡大に意欲を燃やす。

■「自社ブランドはニッチ市場に照準」

当面はHiDMブランドで展開する計画である一方、将来的には自社ブランドでの製品展開も視野に入れる。浅見氏はその時期を21年度ごろと定め、モバイル以外の分野で

(副編集長 稲葉雅也)